

中国电子学会

关于发布中国电子学会-智芯 科研专项（2022）申报指南的通知

为鼓励集成电路科技创新，助力集成电路学科发展和人才成长，中国电子学会联合北京智芯微电子科技有限公司发起设立“中国电子学会-智芯公司科研专项”（下称 CIE-智芯专项）。CIE-智芯专项，面向全国高校、科研院所等相关科研单位，聚焦工业级集成电路设计、工艺、可靠性等基础研究，以及工业芯片应用技术研究，支持开展产学研项目合作。

现将 CIE-智芯专项（2022）申报指南予以发布，请根据要求项目进行项目申报。

一、支持研究主题

1. 芯片可靠性失效机理及原子级缺陷表征技术；
2. 工业设备振动状态智能感知分析技术；
3. 双模通信抗噪声干扰关键技术；
4. 混合能量收集芯片关键技术；
5. 高性能低功耗数字锁相环；
6. RISC-V 架构工业控制处理器体系结构模拟器；
7. 轴向预紧力传感器材料及宽温区标定算法；
8. 声发射传感器压电器件能量感知及传输理论；

9. 高灵敏低噪声磁敏电流传感芯片关键技术；

10. 高灵敏度 CMOS 3D 霍尔传感器技术。

（各研究主题说明详见附件 1）

二、资助计划

1. CIE-智芯专项（2022）资助期限为 2 年。

2. 根据研究内容确定资助金额，每项资助金额 40 万元左右。

三、申报资格要求

1. 项目负责人需是中国电子学会会员。

2. 项目负责人应为高等院校或科研院所全职科研人员。

3. 项目负责人及团队应长期从事与指南支持方向相关的研究工作。

4. 项目负责人应在申报前确认所在单位同意作为项目依托单位签署合作协议，且本人同意签署项目保密协议。

5. 申请人和参与者只能申请或参与 1 项本专项项目。

四、立项管理

1. 智芯公司为每一个入选项目安排合作研究团队，根据评审意见与项目负责人共同讨论优化项目计划书。

2. 项目计划书确定后，中国电子学会将与项目负责人及其所在单位完成项目协议签署及经费拨付，完成立项。

3. 如因入选项目自身原因导致在收到入选通知后三个月内未能完成协议签署的，视为放弃；后续年度如希望重启合作，需重新申请。

五、申报方式

1. 网上填报系统 2022 年 11 月 1 日至 11 月 25 日期间开放。申报书（样表）见附件 2。

2. 填报账号申请。邮件联系专项工作组（ciejd@cie.org.cn），邮件标题：CIE-智芯专项-项目负责人姓名，邮件正文内容包含项目申请人姓名、所在单位、申报主题。

3. 专项工作组会在收到邮件 2 个工作日内回复申请账号。请注意查收邮件。

4. 登录 <http://etst.cie.org.cn>，点击“CIE-智芯专项”，使用收到的账号登录，在线填报。

5. 在申报截止前，可多次登录更新申报材料。

6. 本专项实行无纸化申请。申请人只需在线提交申请书及附件材料。

7. 申请人需征得所在单位同意，并请所在单位对申请人提交材料的真实性和完整性进行认真审核。

六、专项工作组联系方式

（一）中国电子学会

联系人：高琦 孙志玲

联系电话：010-68600697 68600695

（二）北京智芯微电子科技有限公司

联系人：刘景文 高岩

联系电话：010-51963200 51966642

- 附件：1. CIE-智芯科研专项（2022）申报主题及说明
2. CIE-智芯科研专项（2022）申报书（样表）

